

COMPANY

参画企業

光株式会社

光株式会社

<http://www.hikalikk.jp>



高度なレーザー微細加工技術で日本のものづくりに貢献

技術的特徴

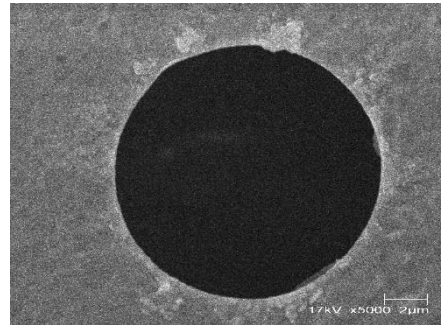
世界最先端のレーザー微細加工技術により、**付加価値が高いものづくりを提供。**材料の種類を問わず、穴あけ、切断、マーキング等様々な加工を実現する。

- ピコ秒レーザー、フェムト秒レーザーなどの超短パルスレーザー加工
 - ・ 高い真円度の微細穴加工
 - ・ テーパーレスの異形状切り出し
 - ・ 微細な溝形成、シャープな微細切断
 - ・ 高アスペクト比、逆テーパ加工
- 多岐に渡る応用分野
 - ・ 薄膜太陽電池
 - ・ 照明用有機EL
 - ・ 自動車、時計、精密機械部品、
 - ・ 高精度測定機器
 - ・ 医療器具

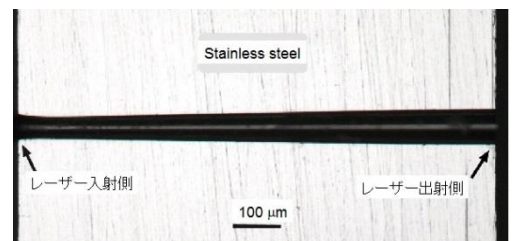
実績

- SEMICON Japan 2014 出展
- ナノ・マイクロビジネス展 出展(2014年)
- MEDTEC Japan 2013 出展
- 第6回レーザー加工技術展 出展(2013年)

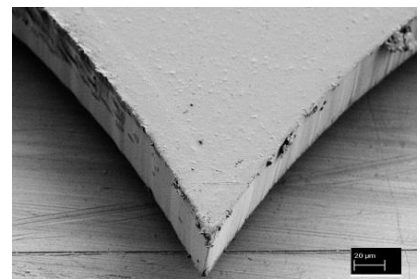
技術の適用例



超微細穴加工 (約Φ10 μm)



逆テーパ穴加工



ポリイミド切断 (厚さ0.03mm)